

证券代码：002008

证券简称：大族激光

## 大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024005

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	高盛证券（8月20日） 易方达（8月21日） 摩根大通（8月21日） 博时基金（8月23日） M&G Investment Management（8月26日） 百年人寿（8月29日） 汇丰银行（9月2日） UBS（9月3日） 长江证券（9月5日） 天风证券（9月11日） 南方基金（9月12日）
<b>时间</b>	2024年8月20日-2024年9月12日
<b>地点</b>	深圳福田香格里拉大酒店 深圳丽思卡尔顿大酒店 上海凯宾斯基大酒店 公司会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	管理与决策委员会副主任兼董事会秘书杜永刚 证券事务代表王琳 证券事务代表胡志毅

投资者关系活  
动主要内容介  
绍

**一、公司 2024 年半年度经营情况**

今年以来，随着下游行业需求的逐渐恢复，公司经营情况逐步改善。公司 2024 年 1-6 月实现营业收入 635,521.00 万元，营业利润 124,843.80 万元，归属于母公司的净利润 122,491.20 万元，扣除非经常性损益后净利润 22,041.35 万元，分别较上年同期增长 4.41%、220.71%、184.81%、15.23%。

**二、公司 PCB 业务情况**

2024 年 1-6 月，PCB 设备业务实现营业收入 15.64 亿元，同比增加 102.89%。2024 年上半年，随着普通多层板市场的竞争加剧，PCB 生产企业对设备效率的要求和自动化需求持续提升。在此背景下，公司开发推出了第二代钻房自动化方案及高功率阻焊激光直接成像系统、自动上下料机械成型机、电测与自动外观检查一体机、自动分拣包装机等自动化、数字化、智能化的解决方案可大幅降低下游客户的人力成本支出，提升客户端设备稼动率及产品品质，已获得客户高度认可。面对 AI 算力产业链持续爆发带来的高速高多层板、任意层 HDI 板、类载板、大尺寸 FC-BGA 封装基板等高阶 PCB 加工需求增长，公司推出了钻测一体化 CCD 六轴独立机械钻孔机、新型激光应用设备等系列产品方案，满足客户对高阶 PCB 加工工艺的要求。未来公司高阶 PCB 加工设备的销售占比将进一步提升。

另一方面，今年以来，众多国内及台资企业在东南亚市场的项目陆续落地，公司与国内多家知名厂商的泰国工厂及泰国 KCE 等当地较大规模的企业达成全面合作，相关订单显著增长。公司已组建海外运营团队，与内资企业联合打造高水平自动化产线，减少对技术人员的依赖，确保相关企业海外 PCB 产能稳定供应，并通过创新型产品及解决方案的广泛推广，力争将公司的品牌价值和影响力复制到海外地区，抓住 PCB 产业转移带来的市场机会，推动海外业务的持续成长。

**三、通用工业激光加工设备市场复苏情况**

2024年1-6月，通用工业激光加工设备业务实现营业收入25.57亿元，同比增长4.03%，其中，高功率激光切割设备实现营业收入12.54亿元，同比增长5.15%。报告期内，公司推出了全球首台150KW超高功率切割机，持续扩大在高端领域的市场影响力，与浙江鼎力、东南网架、中国石油、爱玛科技等客户达成合作。另一方面，根据市场需求，公司同步调整市场策略，持续加大对中低端市场的覆盖和拓展，高功率激光切割设备整体市占率稳步提升。公司在长沙、天津、常州、张家港、济南等地设厂，实现就近生产交付和服务，提升盈利能力。公司在厚板切割效率、坡口特殊加工工艺等关键技术及超高功率激光切割工艺上持续取得突破，并持续加深与行业头部客户的紧密合作关系。

#### **四、半导体设备（含泛半导体）新产品进展**

2024年上半年，半导体和以显示面板为代表的泛半导体行业景气度持续回升，下游客户新项目陆续开始招投标工作，相关订单较去年增长明显。公司持续推进激光切割、钻孔，激光修复，激光剥离等设备的升级和技术改善。在Micro-LED领域，公司同步推进在MIP、COB封装路线的布局，已经实现Micro-LED巨量转移、Micro-LED巨量焊接、Micro-LED修复等设备的生产交付，市场验证反映良好。第三代半导体技术方面，公司研发的碳化硅激光切片设备正在持续推进与行业龙头客户的合作，为规模化生产做准备，并推出了碳化硅激光退火设备新产品。

#### **五、公司当下市场竞争力与未来发展**

公司下游包括消费电子、PCB、新能源、半导体等行业，与宏观经济的整体运行密切相关，目前全球经济仍处于周期性波动当中。公司将持续落实公司“基础器件技术领先，行业装备深耕应用”的发展战略，持续加大对基础器件以及行业专用设备业务的研发和投入，深耕细分行业，做大做强相关产业，不断强化和确立公司在相关产品市场的主导地位，推动公司业务实现持续高质量增长。

	<p><b>六、公司海外布局发展情况</b></p> <p>当前，制造业供应链产地已经呈现多元化的发展趋势，海外设备需求呈明显上升趋势，公司紧跟客户步伐，已高效组建起海外研发销售团队，力争抓住供应链多元化带来的市场机会。</p> <p><b>七、公司回购进展情况</b></p> <p>截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 12,310,392 股，占公司目前总股本的 1.17%，最高成交价格为 21.36 元/股，最低成交价格为 15.41 元/股，成交总金额为 250,072,212.26 元（不含交易费用）。</p> <p><b>八、公司质押情况</b></p> <p>目前，公司实际控制人及控股股东持有股份质押比例为 79.91%。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 9 月 23 日